证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2026-051

有研半导体硅材料股份公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年11月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年11月16日 14点30分

召开地点：北京市西城区新街口外大街2号有研大厦

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月16日

至2026年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本、修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司部分制度的议案	√
2.01	董事会议事规则	√
2.02	独立董事工作制度	√
2.03	防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度	√
2.04	股东会议事规则	√
2.05	募集资金管理制度	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，相关公告已于2026年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。

公司将在2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2026年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.04

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688432	有研硅	2026/11/9

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东会会议的股东可采用信函或电子邮件的方式进行预约。采用电子邮件预约的请于2026年11月13日17时之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱 gritekipo@gritek.com 进行预约登记；信函预约的以收到邮戳为准，信函上请注明“股东会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

（二）登记手续

拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证或护照等其他能够表明身份的有效证件或证明（身份证件）；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1）；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1）。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，现场参会人员建议至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）会议联系方式

地 址：北京市西城区新街口外大街2号D座17层

邮编：100088

联系人：孙媛

电 话：010-82087088

电子邮箱：gritekipo@gritek.com

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年10月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

有研半导体硅材料股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本、修订《公司章程》的议案			
2.00	关于修订公司部分制度的议案			
2.01	董事会议事规则			
2.02	独立董事工作制度			
2.03	防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度			
2.04	股东会议事规则			
2.05	募集资金管理制度			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2026-046

有研半导体硅材料股份公司 关于公司2024年股票期权激励计划 首次授予部分第二个行权期 及预留授予部分第一个行权期 行权条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股票期权拟行权数量：177.06万份。其中，首次授予部分第二个行权期可行权164.10万份，预留授予部分第一个行权期可行权12.96万份。

● 行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”、“有研硅”）于2026年10月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于确认公司2024年股票期权激励计划2025年绩效考核结果的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销公司2024年股票期权激励计划首次及预留部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》。根据《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期的行权条件已经成就。现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划批准及实施情况

（一）股票期权激励计划方案及履行程序

1、2024年9月10日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于＜有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第一次会议审议通过。

同日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于＜有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单＞的议案》，监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年9月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-040），独立董事袁少颖受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、公司于2024年9月11日至2024年9月20日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024年9月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-042）。

4、2024年9月27日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于＜有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

5、2024年9月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-043）。

6、2024年10月10日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意以2024年10月10日为授予日，向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024年10月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（截止授予日）》。

7、2024年10月24日，公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》（公告编号：2024-048），公司于2024年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续，向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。

8、2025年3月14日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。董事会认为本激励计划授予预留部分期权的条件已经成就，同意以2025年3月14日为授予日，以9.11元/份的行权价格向34名激励对象授予90.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第三次会议审议通过。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、公司于2025年3月15日至2025年3月24日在公司内部对预留授予拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共10天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。具体内容详见公司于2025年3月25日披露的《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

10、2025年4月23日，公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划预留授予完成登记的公告》（公告编号：2025-020），股票期权预留授予登记完成日为2025年4月22日，股票期权预留授予登记数量为90.00万份，股票期权预留授予登记人数为34人。

11、2025年10月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据2024年第二次临时股东大会的授权，对2024年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，行权价格由9.11元/股调整为9.05元/股。同时，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案》《关于确认公司2024年股票期权激励计划绩效考核结果的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》。鉴于本激励计划首次授予第一个行权期公司层面2024年业绩考核达到触发值但未达到目标值，公司层面可行权比例为80%，部分激励对象因个人考核条件未达成A导致不能完全行权，公司及个人考核不达标部分的股票期权合计75.42万份，公司将注销该部分已授予但无法行权的股票期权。2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期实际可行权激励对象为92名，行权数量为268.08万份，行权价格为9.05元/股。薪酬和考核委员会发表了明确同意的意见。

12、2025年10月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-037）及《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-038）。

13、公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期第一次行权新增股份于2025年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权的激励对象为92人，行权股票数量为268.08万股，上市流通时间为2025年12月18日。行权后，公司总股本由1,247,621,058股变更为1,250,301,858股。

14、2025年12月13日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权结果暨股票上市的公告》（公告编号：2025-044）。

15、2026年10月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据2024年第二次临时股东大会的授权，对2024年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，行权价格由9.05元/股调整为8.995元/股。同时，第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认公司2024年股票期权激励计划2025年绩效考核结果的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销公司2024年股票期权激励计划首次及预留部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》。本激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期，公司层面2025年业绩考核达到触发值但未达到目标值，可行权比例为50%；部分激励对象因个人考核条件未达成A不能完全行权；首次授予激励对象中有1名激励对象因离职不可行权。综上，本次激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就人员合计91人，可行权的股票期权数量合计164.10万份；预留授予部分第一个行权期行权条件成就人员合计34人，可行权的股票期权数量合计12.96万份；上述已获授予但未获准行权的股票期权数量合计198.24万份将予以注销。薪酬和考核委员会发表了明确同意的意见。

14、2025年12月13日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权结果暨股票上市的公告》（公告编号：2025-044）。

15、2026年10月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据2024年第二次临时股东大会的授权，对2024年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，行权价格由9.05元/股调整为8.995元/股。同时，第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认公司2024年股票期权激励计划2025年绩效考核结果的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销公司2024年股票期权激励计划首次及预留部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》。本激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期，公司层面2025年业绩考核达到触发值但未达到目标值，可行权比例为50%；部分激励对象因个人考核条件未达成A不能完全行权；首次授予激励对象中有1名激励对象因离职不可行权。综上，本次激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就人员合计91人，可行权的股票期权数量合计164.10万份；预留授予部分第一个行权期行权条件成就人员合计34人，可行权的股票期权数量合计12.96万份；上述已获授予但未获准行权的股票期权数量合计198.24万份将予以注销。薪酬和考核委员会发表了明确同意的意见。

二、本次股票期权激励计划行权价格的调整说明

（一）调整原因

2026年4月28日，公司召开2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,250,301,858股，扣除回购股份3,555,336股，以此计算本次拟派发现金红利68,571,058.71元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的32.77%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研半导体硅材料股份公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011）。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，若公司发生派息的情况，股票期权的行权价格将根据本激励计划做相应的调整。

（二）调整情况

根据公司《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，本激励计划公告日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息的情况，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下：

P＝P0－V

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。根据以上公式，本次调整后的行权价格=9.05-0.055=8.995元/股。公司董事会根据2024年第二次临时股东大会授权对2024年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，经过本次调整后，行权价格由9.05元/股调整为8.995元/股。

三、本次调整对公司的影响

本次股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，也不会影响公司股票期权激励计划的继续实施。

四、董事会薪酬和考核委员会意见

公司董事会薪酬和考核委员会认为：本次调整符合《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，调整程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。同意对2024年股票期权激励计划行权价格进行调整。

五、法律意见书的结论性意见

北京德恒律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司2024年股票期权激励计划调整行权价格已取得了现阶段必要的批准与授权；公司本次股票期权激励计划调整行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》以及《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年10月29日

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2026-047

有研半导体硅材料股份公司 关于注销公司2024年股票期权激励计划 首次及预留部分已授予但未获准行权的 股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销公司2024年股票期权激励计划首次及预留部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》。根据《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意注销2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留部分第一个行权期已授予但未获准行权的股票期权合计198.24万份。现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划批准及实施情况

1、2024年9月10日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于＜有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第一次会议审议通过。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024年10月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《有研半导体硅材料股份公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-047）及《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单（截止授予日）》。

2、2024年10月24日，公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》（公告编号：2024-048），公司于2024年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续，向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。

3、2025年3月14日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。董事会认为本激励计划授予预留部分期权的条件已经成就，同意以2025年3月14日为授予日，以9.11元/份的行权价格向34名激励对象授予90.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第三次会议审议通过。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

4、公司于2025年3月15日至2025年3月24日在公司内部对预留授予拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共10天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。具体内容详见公司于2025年3月25日披露的《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

5、2025年4月23日，公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划预留授予完成登记的公告》（公告编号：2025-020），股票期权预留授予登记完成日为2025年4月22日，股票期权预留授予登记数量为90.00万份，股票期权预留授予登记人数为34人。

6、2025年10月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据2024年第二次临时股东大会的授权，对2024年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，行权价格由9.11元/股调整为9.05元/股。同时，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案》《关于确认公司2024年股票期权激励计划绩效考核结果的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》。鉴于本激励计划首次授予第一个行权期公司层面2024年业绩考核达到触发值但未达到目标值，公司层面可行权比例为80%，部分激励对象因个人考核条件未达成A导致不能完全行权，公司及个人考核不达标部分的股票期权合计75.42万份，公司将注销该部分已授予但无法行权的股票期权。2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期实际可行权激励对象为92名，行权数量为268.08万份，行权价格为9.05元/股。薪酬和考核委员会发表了明确同意的意见。

7、2025年10月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-037）及《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-038）。

8、公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期第一次行权新增股份于2025年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权的激励对象为92人，行权股票数量为268.08万股，上市流通时间为2025年12月18日。行权后，公司总股本由1,247,621,058股变更为1,250,301,858股。

9、2025年12月13日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权结果暨股票上市的公告》（公告编号：2025-044）。

10、2026年10月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据2024年第二次临时股东大会的授权，对2024年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，行权价格由9.05元/股调整为8.995元/股。同时，第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认公司2024年股票期权激励计划2025年绩效考核结果的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销公司2024年股票期权激励计划首次及预留部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》。本激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期，公司层面2025年业绩考核达到触发值但未达到目标值，可行权比例为50%；部分激励对象因个人考核条件未达成A不能完全行权；首次授予激励对象中有1名激励对象因离职不可行权。综上，本次激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就人员合计91人，可行权的股票期权数量合计164.10万份；预留授予部分第一个行权期行权条件成就人员合计34人，可行权的股票期权数量合计12.96万份；上述已获授予但未获准行权的股票期权数量合计198.24万份将予以注销。薪酬和考核委员会发表了明确同意的意见。

二、本次注销部分股票期权的情况

1、注销原因

根据《激励计划（草案）》的相关规定，2024年股票期权首次授予的激励对象中1人因离职，不再具备激励对象资格，公司将注销其全部已获授但未获准行权的8.40万份股票期权。

鉴于本激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期，公司层面2025年业绩考核达到触发值但未达到目标值，可行权比例为50%；部分激励对象因个人考核条件未达成A不能完全行权。公司将注销该部分已授予但未获准行权的189.84万份股票期权。

2、注销数量

综上，公司拟注销的股票期权合计198.24万份。

三、本次股票期权注销对公司股权结构和上市条件的影响

公司2024年股票期权激励计划注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、薪酬和考核委员会意见

薪酬和考核委员会认为：公司本次注销2024年股票期权激励计划首次及预留部分已授予但未获准行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《激励计划（草案）》等相关规定，决策程序合法合规。该事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，薪酬和考核委员会一致同意公司对相关股票期权予以注销处理。

五、法律意见书的结论性意见

北京德恒律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司2024年股票期权激励计划注销部分股票期权已取得了现阶段必要的批准与授权；公司本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》以及《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，并按照有关规定办理本次注销股票期权的相关手续。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年10月29日

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2026-045

有研半导体硅材料股份公司 关于调整公司2024年股票期权激励计划 行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将具体调整事项说明如下：

一、股票期权激励计划方案及履行程序

1、2024年9月10日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于＜有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第一次会议审议通过。

同日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于＜有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单＞的议案》，监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年9月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-040），独立董事袁少颖受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、公司于2024年9月11日至2024年9月20日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024年9月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-042）。

4、2024年9月27日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于＜有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

5、2024年9月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-043）。

6、2024年10月10日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意以2024年10月10日为授予日，向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024年10月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（截止授予日）》。

7、2024年10月24日，公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》（公告编号：2024-048），公司于2024年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续，向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。

8、2025年3月14日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。董事会认为本激励计划授予预留部分期权的条件已经成就，同意以2025年3月14日为授予日，以9.11元/份的行权价格向34名激励对象授予90.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第三次会议审议通过。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、公司于2025年3月15日至2025年3月24日在公司内部对预留授予拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共10天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。具体内容详见公司于2025年3月25日披露的《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

10、2025年4月23日，公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划预留授予完成登记的公告》（公告编号：2025-020），股票期权预留授予登记完成日为2025年4月22日，股票期权预留授予登记数量为90.00万份，股票期权预留授予登记人数为34人。

11、2025年10月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据2024年第二次临时股东大会的授权，对2024年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，行权价格由9.11元/股调整为9.05元/股。同时，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案》《关于确认公司2024年股票期权激励计划绩效考核结果的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2024年股票期权激励计划首次及预留部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》。鉴于本激励计划首次授予第一个行权期公司层面2024年业绩考核达到触发值但未达到目标值，公司层面可行权比例为80%，部分激励对象因个人考核条件未达成A导致不能完全行权，公司及个人考核不达标部分的股票期权合计75.42万份，公司将注销该部分已授予但无法行权的股票期权。2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期实际可行权激励对象为92名，行权数量为268.08万份，行权价格为9.05元/股。薪酬和考核委员会发表了明确同意的意见。

12、2025年10月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-037）及《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-038）。

13、公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期第一次行权新增股份于2025年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权的激励对象为92人，行权股票数量为268.08万股，上市流通时间为2025年12月18日。行权后，公司总股本由1,247,621,058股变更为1,250,301,858股。

14、2025年12月13日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权结果暨股票上市的公告》（公告编号：2025-044）。

15、2026年10月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据2024年第二次临时股东大会的授权，对2024年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，行权价格由9.05元/股调整为8.995元/股。同时，第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认公司2024年股票期权激励计划2025年绩效考核结果的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销公司2024年股票期权激励计划首次及预留部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》。本激励计划首次授予部分第二个行权期